

## SL-SMT 5.00HC/04/180 3.2SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

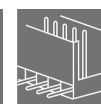
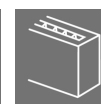
Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Изображение изделия



Термостойкий открытый штекерный соединитель прямой конфигурации. Упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 мм оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 мм подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = высокоточный.

## Основные данные для заказа

Исполнение	Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, с боковой стороны открыто, Соединение THT/THR под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 4, 180°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, черный, Таре
Номер для заказа	<a href="#">2441070000</a>
Тип	SL-SMT 5.00HC/04/180 3.2SN BK RL
GTIN (EAN)	4050118455410
Кол.	250 Шт.
Продуктное отношение	IEC: 400 V / 27.5 A UL: 300 V / 18.5 A
Упаковка	Таре

Дата создания 7 июля 2024 г. 16:28:09 CEST

## SL-SMT 5.00HC/04/180 3.2SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	8,5 мм	Глубина (дюймов)	0,335 inch
Высота	15,2 мм	Высота (в дюймах)	0,598 inch
Высота, мин.	12 мм	Ширина	20 мм
Ширина (в дюймах)	0,787 inch	Масса нетто	1,837 g

## Упаковка

Упаковка уровня ESD	токорассеивающий	Упаковка	Tape
Длина VPE	332 мм	VPE с	332 мм
Высота VPE	64 мм	Глубина ленты (T2)	17,5 мм
Ширина ленты (Ш)	56 мм	Глубина ленты с кармашками (K0)	17 мм
Высота ленты с кармашками (A0)	8,2 мм	Ширина ленты с кармашками (B0)	43,12 мм
Разделение кармашка ленты (P1)	16 мм	Перфорация для разделения ленты (E)	1,75 мм
Разделение кармашка ленты (F)	26,2 мм	Диаметр катушки с лентой Ø (A)	330 mm
Поверхностное сопротивление	$R_s = 10^9 - 10^{12} \Omega$	Ширина контактной площадки Pick & Place ( $W_{PPP}$ )	9,6 мм
Длина контактной площадки Pick & Place ( $L_{PPP}$ )	12,36 мм	Диаметр извлекаемой поверхности (Ø $D_{\text{макс.}}$ )	8,5 мм
Выступ 1 контактной площадки Pick & Place ( $L_{01 (PPP)}$ )	2 мм	Выступ 2 контактной площадки Pick & Place ( $P_{02 (PPP)}$ )	2,3 мм

## Системные характеристики

Серия изделия	OMNIMATE Signal — серия BL/SL 5.00	Вид соединения	Соединение с платой
Монтаж на печатной плате	Соединение THT/THR под пайку	Шаг в мм (P)	5 мм
Шаг в дюймах (P)	0,197 "	Угол вывода	180°
Количество полюсов	4	Количество контактных штырьков на полюс	1
Длина контактного штифта (l)	3,2 мм	Допуск на длину выводов под пайку	+0,1 / -0,2 mm
Размеры выводов под пайку	d = 1,2 мм, восьмиугольный	Размеры выводов под пайку = допуск d	0 / -0,03 mm
Допуск на диаметр монтажного отверстия (D)	+ 0,1 мм	L1 в мм	15 мм
L1 в дюймах	0,591 "	Количество рядов	1
Количество полюсных рядов	2	Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106	защита от доступа пальцем, без проникновения/защита от доступа тыльной стороны руки, с проникновением
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470	IP 20 с проникновением/IP 10 без проникновения	Вид защиты	IP20
Объемное сопротивление	≤5 mΩ	Кодируемый	Да
Усилие вставки на полюс, макс.	7 N	Усилие вытягивания на полюс, макс.	5,5 N

## SL-SMT 5.00HC/04/180 3.2SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Данные о материалах

Изоляционный материал	LCP GF	Цветовой код	черный
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 9011	Группа изоляционного материала	IIIa
Сравнительный показатель пробоя (CTI)	≥ 175	Moisture Level (MSL)	1
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Материал контакта	Сплав меди
Поверхность контакта	луженые	Структура слоев соединения под пайку	1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn матовый
Структура слоев штепсельного контакта	1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn матовый	Температура хранения, мин.	-40 °C
Температура хранения, макс.	70 °C	Рабочая температура, мин.	-50 °C
Рабочая температура, макс.	100 °C	Температурный диапазон монтажа, мин.	-30 °C
Температурный диапазон монтажа, макс.	100 °C		


## Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту	IEC 60664-1, IEC 61984	Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C)	27,5 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C)	19 A	Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C)	24 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C)	16,5 A	Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2	400 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2	320 V	Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3	250 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2	4 kV	Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2	4 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3	4 kV		

## Номинальные характеристики по CSA

Номинальное напряжение (группа использования B/CSA)	300 V	Номинальное напряжение (группа использования D/CSA)	300 V
Номинальный ток (группа использования B/CSA)	15 A	Номинальный ток (группа использования D/CSA)	15 A

## Номинальные характеристики по UL 1059

Институт (UR)		Сертификат № (UR)	E60693
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059)	300 V	Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059)	300 V
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059)	18,5 A	Номинальный ток (группа использования D/UL 1059)	10 A
Ссылка на утвержденные значения	В технических характеристиках приведены максимальные значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.		

## SL-SMT 5.00HC/04/180 3.2SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Классификации

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01	ECLASS 13.0	27-46-02-01

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC

/

## Важное примечание

Соответствие IPC	Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания	<ul style="list-style-type: none"><li>В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой</li><li>Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев</li></ul>

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E60693

## Загрузки

Уведомление об изменении продукта	<a href="#">PCN 2015 208 PL30X SC-SMT SL SMT 3.xx 5.xx neue Tapeverpackung Step 4 DE</a> <a href="#">PCN 2015 208 PL30X SC-SMT SL SMT 3.xx 5.xx new Tape Packaging Step 4 EN</a> <a href="#">Changeover to ESD bags for "Tape on Reel" products</a> <a href="#">Umstellung auf ESD-Beutel bei „Tape on Reel“ Produkten</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	<a href="#">FL DRIVES EN</a> <a href="#">FL DRIVES DE</a>
Информационный документ: технология поверхностного монтажа	<a href="#">Download Whitepaper</a>

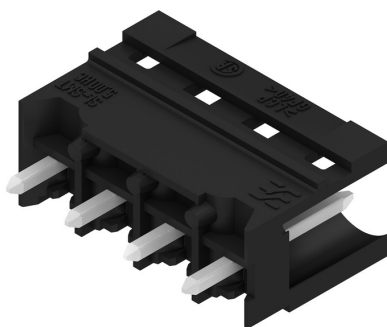
## SL-SMT 5.00HC/04/180 3.2SN BK RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

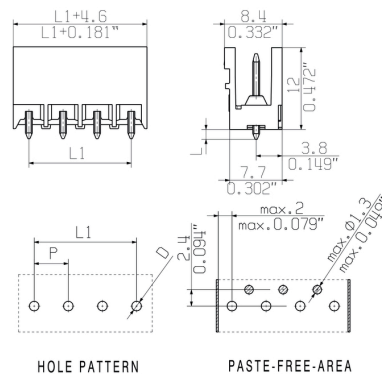
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Изображение изделия



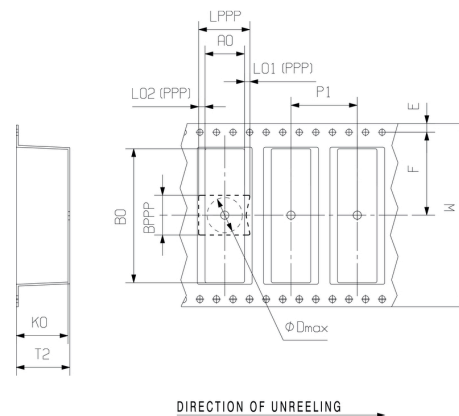
### Dimensional drawing



### Dimensional drawing



### Dimensional drawing

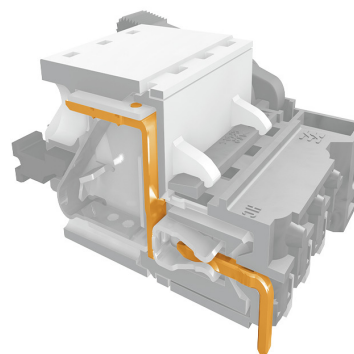


### Пример использования



Compliant with existing standards

### Преимущество изделия



Safe power transmission  
Proven properties

**SL-SMT 5.00HC/04/180 3.2SN BK RL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Преимущество изделия



Compliant with existing standards

## Recommended wave soldering profiles

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Single Wave:



### Double Wave:



### Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

## Recommended reflow soldering profile

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



## Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically  $\leq +3\text{K/s}$ . In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at  $\geq -6\text{K/s}$  solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.